



## 中国移动TD-LTE终端集采出炉：高通独大

7月11日上午消息，备受业界关注的中国移动TD-LTE终端第二季度集采已于日前正式结束。此次集采的规模约为20万部，其中包括MiFi(约15万部)、数据卡(约3万部)、CPE(约2万部)以及部分TD-LTE手机。

此次20万部集采也是中国移动TD-LTE“双百计划”的重要组成部分。在今年9月份，中国移动还将启动规模更大的TD-LTE终端集采，以期能够在年内实现100万部终端的集采数量。

据参与招标的知情人士透露，中国移动的此次TD-LTE终端集采，让业界产生了不少的困惑。首先是中国移动改变了过去普惠产业链下游的举措，再次将价格演绎到了极致；其次，在芯片领域高通一家独大的局面并没有改善，国产芯片中也只有海思入围；第三，中国移动将很多并不很契合实际需求的指标摆在了重要位置，比如单芯片的一票否决，将众多国产芯片厂商拒之门外。

### 集采结果：变与不变

从中国移动公布的结果来看，数据卡模组产品有

华为、上海贝尔、达富电脑、UT斯达康等4家企业入围；MiFi模组产品有华为、中兴通讯、大唐电信、德赛电子、福建瑞恒、江苏荣讯、大唐移动、UT斯达康、天津中启创等9家企业入围；CPE模组产品有达富电脑、中兴通讯、华为终端等3家企业入围；手机模组产品则由三星、华为、北京百纳威尔、宇龙、索尼移动、中兴等6家分享。

与去年集采结果相比，今年的TD-LTE集采结果存在两种态势：一种是中国移动对各终端厂商的政策态度发生明显改变，由普惠回归唯价格论；另一种是中国移动对芯片厂商的钟情程度未变，高通仍旧一家独大。

据了解，为刺激TD-LTE整个产业链的发展，让更多的企业参与其中，中国移动在去年集采时改变方案，采取普惠政策，入围的终端厂家多达15家，既有传统的终端厂商，也有从OEM转型过来的台资企业。

然而，据知情人透露，今年中国移动又走回集采政策老路，采取价低者胜，因此，此次入围的终端厂商数量有所下降：除手机模组产品由3家扩展到6家外，